

2019年3月13日

イーヴィグループ

パナソニック スマートファクトリーソリューションズ株式会社

イーヴィグループとパナソニック プラズマダイシング工程におけるレジスト塗布ソリューションを提供

イーヴィグループ(本社:オーストリア、ザンクトフローリアン・アム・イン、社長:エリック・タルナー/以下 EVG)とパナソニック スマートファクトリーソリューションズ株式会社(本社:大阪府門真市、代表取締役社長:青田広幸/以下 PSFS)は、今後成長が期待される IoT 向けセンサー・MEMS・RFID・CMOS イメージセンサーおよび薄型メモリー向けに開発されたプラズマダイシング工法において、両社で連携を図り、その前工程に当たるレジスト塗布工程で新しいソリューションの提供を2019年3月13日より開始します。

プラズマダイシング工法は、センサー・MEMS・RFID など小チップにおいて、ウエハー全面の一括高速加工を可能とし、CMOS イメージセンサーでは切削粉が出ないことによる高歩留まり、メモリーではウエハー薄化に対してもダメージフリーで高品質を実現するといった特長があります。

プラズマダイシング工法の前工程においては、ウエハー表面にマスクとなるレジストを数十 μm の厚膜で塗布し、ダイシング部をレーザーやフォトリソでパターンニングします。しかしながら、この工程では、多層の配線構造を持つウエハー表面に5 μm 程度の段差があり、さらに電極部にはバンプを持つウエハーが多いため、プラズマダイシング用レジストを均一な厚膜で塗布できないといった課題がありました。

この課題を解決するため、EVGは塗布装置 EVG100 シリーズにおいて、独自の OmniSpray®技術によりプラズマダイシング向けにウエハー表面の段差構造に依存しない均一な塗布方法を開発し、従来の技術では困難であったバンプ付きウエハーに均一な厚膜でレジストを塗布することが可能となりました。

さらに PSFS は、大阪府門真市にあるプラズマダイシング実証センターに EVG 100 シリーズ を導入し、レジストをバンプ付きウエハー表面に塗布・パターンニングした後、PSFS 製プラズマダイサー APX300 ダイサーモジュールで高速・高品質にダイシングするソリューションを開発しました。

EVGとPSFSは、プラズマダイシング実証センターにおける実証を通して、この新しいレジスト塗布ソリューションの提供を開始し、お客様のダイシング品質、生産性向上などへの貢献を目指していきます。

【お問い合わせ先】

イーヴィグループ

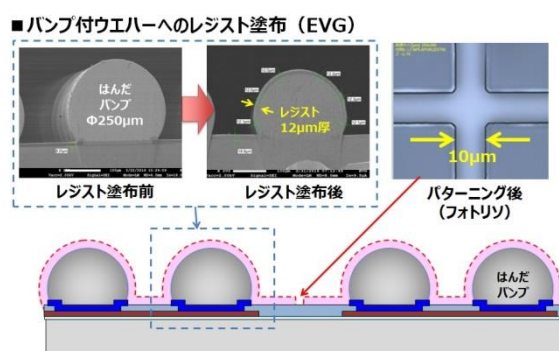
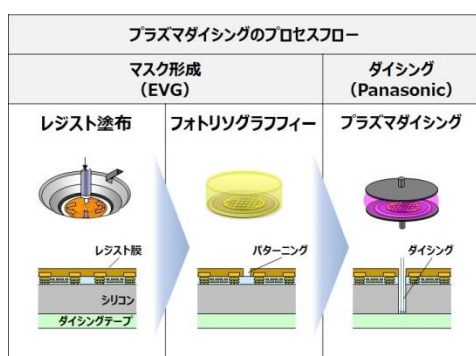
マーケティング & コミュニケーション担当

TEL: +43-7712-5311-0

パナソニック スマートファクトリーソリューションズ株式会社

経営企画部

TEL: 050-3487-3587



EVG 製レジスト塗布装置 EVG150



PSFS 製 APX300 ダイサーモジュール

以上